SiC 晶圆检测设备

1. 系统需求功能描述：

主要是针对SiC外延片及晶圆衬底，通过AOI和PL的功能非接触及非破坏性的方式检测缺陷

1. 技术指标要求
2. 最大可检测8inch SiC外延片，最好能包括破片检测
3. 设备需同时包括AOI和PL检测功能
4. 缺陷检出能力≤0.3μm
5. 定位准确性≤5μm
6. 对位准确性≤±5μm
7. 具备缺陷检测功能
8. 具备衬底表面粗糙度测试功能
9. 具备明暗场
10. 具备深度学习功能
11. 具备KOH检测以及缺陷分类
12. 具备衬底BSF检测功能
13. 能够测试或者估算出对应光谱
14. 系统配置
15. 平台具备XYZ轴移动功能
16. 具备高分辨率单色相机以及彩色复查相机
17. 控制系统能包括控制部分（如主机），图像处理单元，操作设备（如键盘鼠标），显示器以及UPS
18. 安全设备能包括信号塔、紧急停止按钮，安全感应sensor，抗震措施（如抗震台）